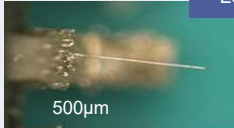
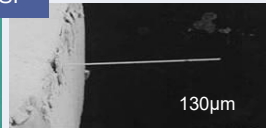
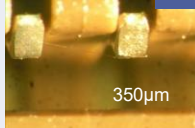
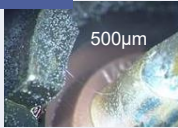


ウィスカ評価試験サービス

ご要求項目の評価・評価項目立案・改善策のアドバイスと幅広くサポートいたします。

実際の評価を基に、サービス内容の事例を紹介させていただきます。

お客様活用事例	評価内容																																		
・ご依頼[お客様] ↓ ・ウィスカの発生メカニズム - 評価項目・条件のアドバイス - ウィスカ実例 ↓ ・結果報告(中間) - ウィスカ長さ ↓ ・結果報告(最終) - ウィスカ長さ - 使用上での影響度	お問い合わせ、ご相談 ・当社技術者にて、ご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせてください(無料)。 ・ご支障ない範囲で、使用環境/条件をお聞きしながら、評価項目や内容の調整をさせていただきます。 評価条件 ・ご要望の評価段階にて、状況をご報告いたします。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">機関</th> <th colspan="4">試験項目</th> <th rowspan="2">ウィスカ長さ判定基準</th> </tr> <tr> <th>常温</th> <th>高温高湿</th> <th>温度サイクル</th> <th>常温かん合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JIS IEC</td> <td>30°C, 60% 25°C, 50% 4,000h</td> <td>55°C, 85% 2,000h</td> <td>-40~85°C -55~85°C -40~125°C -55~125°C 2,000cy 1,000cy</td> <td>—</td> <td>50μm以下</td> </tr> <tr> <td>JEDEC</td> <td>30°C, 60% 4,000h (技術認定)</td> <td>55°C, 85% 4,000h (技術認定)</td> <td>-40~85°C -55~85°C 1,500cy (技術認定)</td> <td>—</td> <td>リード間、部品タイプ等により許容値を設定</td> </tr> <tr> <td>JEITA</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>25°C, 50% 2,000h</td> <td>隣接端子間の1/2以下</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>下地の拡散による応力</td> <td>めっき酸化、腐食による応力</td> <td>母材とめっきの熱膨張差による応力</td> <td>コネクタのみ接触部の応力</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> ・JIS: 日本工業規格 (Japanese Industrial Standards) ・IEC: 国際電気標準会議 (International Electrotechnical Commission) ・JEDEC: 半導体技術協会 (JEDEC Solid State Technology Association) ・JEITA: 電子情報技術産業協会 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) ウィスカ実例 LSI  端子(曲げ部)  端子(曲げ部) コネクタ  FPCコネクタ (コンタクト間ショート)  丸型コネクタ (端子-シェル間ショート)	機関	試験項目				ウィスカ長さ判定基準	常温	高温高湿	温度サイクル	常温かん合	JIS IEC	30°C, 60% 25°C, 50% 4,000h	55°C, 85% 2,000h	-40~85°C -55~85°C -40~125°C -55~125°C 2,000cy 1,000cy	—	50μm以下	JEDEC	30°C, 60% 4,000h (技術認定)	55°C, 85% 4,000h (技術認定)	-40~85°C -55~85°C 1,500cy (技術認定)	—	リード間、部品タイプ等により許容値を設定	JEITA	—	—	—	25°C, 50% 2,000h	隣接端子間の1/2以下	備考	下地の拡散による応力	めっき酸化、腐食による応力	母材とめっきの熱膨張差による応力	コネクタのみ接触部の応力	—
機関	試験項目				ウィスカ長さ判定基準																														
	常温	高温高湿	温度サイクル	常温かん合																															
JIS IEC	30°C, 60% 25°C, 50% 4,000h	55°C, 85% 2,000h	-40~85°C -55~85°C -40~125°C -55~125°C 2,000cy 1,000cy	—	50μm以下																														
JEDEC	30°C, 60% 4,000h (技術認定)	55°C, 85% 4,000h (技術認定)	-40~85°C -55~85°C 1,500cy (技術認定)	—	リード間、部品タイプ等により許容値を設定																														
JEITA	—	—	—	25°C, 50% 2,000h	隣接端子間の1/2以下																														
備考	下地の拡散による応力	めっき酸化、腐食による応力	母材とめっきの熱膨張差による応力	コネクタのみ接触部の応力	—																														

- 個別作業も承ります。ご要望に沿った作業内容や報告スケジュールにて対応させていただきます。
- 問題工程確認、評価基準策定、部品メーカー等との打ち合わせもサポートさせていただきます。
- その他柔軟に品質問題に対応させていただきますので、まずはお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社 信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時~17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く